

# 2018年中国IC封装行业分析报告- 市场深度分析与发展前景预测

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国IC封装行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/330008330008.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

先进封装是电子产品小型化趋势未来最重要的推动力。摩尔定律在5nm 时候很可能会碰到物理极限，同时14nm以下新制程的开发难度和投资度呈现出指数级增长，因此IC产品的小型化的另一个核心思路是在封测环节利用更先进封装技术来实现。

图表：不同制程的晶圆产线的研发投入

先进封装方向：SiP、3D、MEMS 等。封装的本质是电气互连，在芯片小型化和高效率的需求驱动下，SiP 封装、3D 封装、MEMS 封装等新型工艺将是全球半IC封装产业的可以发展方向。

先进封装的发展方向是“以点替代线的连接”，完成“点的连接”的核心工艺是 TSV 和 Bumping (Copper Pillar)：

封装技术更新的驱动力是使封装器件微型化、低成本和高性能，从芯片互连技术角度看，封装技术发展路径是，第一代WB技术，第二代TAB技术，第三代FC技术，第四代TSV技术，这是电气连接技术“点替代线”思路的体现；

引线键合是空间操作，点对点连接是平面操作，点代替线可以使连接电路的空间分布更加简单，从而减小封装体积；点替代线可以充分利用芯片的自身面积，可以减小封装面积，实现微型化；

此外，Bumping 技术是可以批量生产的，而键合技术如 WB 或者 TAB 只能对单个芯片操作，因此点替代线可以实现晶圆级封装WLP，从而大大减少封装成本；

点对点连接，可以缩短连接电路长度，减少系统寄生电容干扰、电阻发热和信号延迟，提高模组性能。

图表：先进封装技术发展路径

TSV (Through Silicon Via, 硅通孔) 工艺简介：通过在晶粒内部打垂直通孔并填充金属 (Cu/W)，将晶粒正面焊盘上的 I/O 信号引至背面，从而实现3D IC内部各层晶粒间的垂直互连，是SiP/3D封装中的关键工序。

TSV制造工艺包括通孔制造，绝缘层、阻挡层制备，通孔金属化，芯片减薄，技术难度远大于传统Wire Bonding技术；TSV 技术是实现相邻晶粒间垂直互连的最短连接方式，可降低芯片功耗，提高运行速度。

从纵向看，TSV将晶粒的电气连接端口限制在一个“点” (Wire Bonding 则需用“线”将端口引出)，减小了3D IC的水平面积，同时TSV实现晶粒垂直互连不需要像Package on Package等3D封装使用基板，减少了芯片厚度，从而使芯片的三维封装密度达到最大；

图表：电子显微镜下的TSV 结构图

Bumping 技术简介：通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程以“点替代线”的发展趋势，广泛应用于FC、WLP、CSP、3D等先进封装。它提供了芯片之间、芯片和基板之间的“点连接”，由于避免了传统Wire Bonding向四周辐射的

金属“线连接”，减小了芯片面积（封装效率 100%），此外凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以做得很高，便于满足芯片性能提升的需求；

从工艺来看，加工时首先在晶圆上生长钝化层，然后用Ti/Ni在其上制作金属层 UBM，最后利用焊接/电镀在 UBM上生长出铅锡合金球/金球形成Bumping；Copper Pillar 是 Bumping 互连技术中最先进的一种，用铜柱替换金属球作为芯片表面的电气接口，由于相邻铜柱轴间距很小（目前Amkor为50微米），因而I/O引脚密度可以做的更高，芯片尺寸可进一步缩小。

图表：Bumping 技术分支

观研天下发布的《2018年中国IC封装行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、IC封装T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 【报告大纲】

### 第一章 2015-2017年中国IC封装行业发展概述

#### 第一节 IC封装行业发展情况概述

- 一、IC封装行业相关定义
- 二、IC封装行业基本情况介绍
- 三、IC封装行业发展特点分析

#### 第二节 中国IC封装行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍

## 二、IC封装行业产业链条分析

### 三、中国IC封装行业产业链环节分析

#### 1、上游产业

#### 2、下游产业

### 第三节 中国IC封装行业生命周期分析

#### 一、IC封装行业生命周期理论概述

#### 二、IC封装行业所属的生命周期分析

### 第四节 IC封装行业经济指标分析

#### 一、IC封装行业的赢利性分析

#### 二、IC封装行业的经济周期分析

#### 三、IC封装行业附加值的提升空间分析

### 第五节 国中IC封装行业进入壁垒分析

#### 一、IC封装行业资金壁垒分析

#### 二、IC封装行业技术壁垒分析

#### 三、IC封装行业人才壁垒分析

#### 四、IC封装行业品牌壁垒分析

#### 五、IC封装行业其他壁垒分析

## 第二章 2015-2017年全球IC封装行业市场发展现状分析

### 第一节 全球IC封装行业发展历程回顾

### 第二节 全球IC封装行业市场区域分布情况

### 第三节 亚洲IC封装行业地区市场分析

#### 一、亚洲IC封装行业市场现状分析

#### 二、亚洲IC封装行业市场规模与市场需求分析

#### 三、亚洲IC封装行业市场前景分析

### 第四节 北美IC封装行业地区市场分析

#### 一、北美IC封装行业市场现状分析

#### 二、北美IC封装行业市场规模与市场需求分析

#### 三、北美IC封装行业市场前景分析

### 第五节 欧盟IC封装行业地区市场分析

#### 一、欧盟IC封装行业市场现状分析

#### 二、欧盟IC封装行业市场规模与市场需求分析

#### 三、欧盟IC封装行业市场前景分析

### 第六节 2018-2024年世界IC封装行业分布走势预测

### 第七节 2018-2024年全球IC封装行业市场规模预测

## 第三章 2015-2017年中国IC封装产业发展环境分析

## 第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

## 第二节 中国IC封装行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

## 第三节 中国IC封装产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、IC封装环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

## 第四章 2015-2017年中国IC封装行业运行情况

### 第一节 中国IC封装行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

### 第二节 中国IC封装行业市场规模分析

### 第三节 中国IC封装行业供应情况分析

### 第四节 中国IC封装行业需求情况分析

### 第五节 中国IC封装行业供需平衡分析

### 第六节 中国IC封装行业发展趋势分析

## 第五章 中国IC封装所属行业运行数据监测

### 第一节 中国IC封装所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

### 第二节 中国IC封装所属行业产销与费用分析

- 一、产成品分析
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国IC封装所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国IC封装市场格局分析

第一节 中国IC封装行业竞争现状分析

一、中国IC封装行业竞争情况分析

二、中国IC封装行业主要品牌分析

第二节 中国IC封装行业集中度分析

一、中国IC封装行业市场集中度分析

二、中国IC封装行业企业集中度分析

第三节 中国IC封装行业存在的问题

第四节 中国IC封装行业解决问题的策略分析

第五节 中国IC封装行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国IC封装行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国IC封装行业消费特点

第二节 中国IC封装行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 IC封装行业成本分析

### 第三节 IC封装行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

### 第四节 中国IC封装行业价格现状分析

### 第五节 中国IC封装行业平均价格走势预测

- 一、中国IC封装行业价格影响因素
- 二、中国IC封装行业平均价格走势预测
- 三、中国IC封装行业平均价格增速预测

## 第八章 2015-2017年中国IC封装行业区域市场现状分析

### 第一节 中国IC封装行业区域市场规模分布

#### 第二节 中国华东地IC封装市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区IC封装市场规模分析
- 四、华东地区IC封装市场规模预测

#### 第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区IC封装市场规模分析
- 四、华中地区IC封装市场规模预测

#### 第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区IC封装市场规模分析

## 第九章 2015-2017年中国IC封装行业竞争情况

### 第一节 中国IC封装行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

### 第二节 中国IC封装行业SWOT分析

- 一、行业优势分析



## 二、行业劣势分析

## 三、行业机会分析

## 四、行业威胁分析

### 第三节 中国IC封装行业竞争环境分析（IC封装T）

#### 一、政策环境

#### 二、经济环境

#### 三、社会环境

#### 四、技术环境

### 第十章 IC封装行业企业分析（随数据更新有调整）

#### 第一节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 1、主要经济指标情况

##### 2、企业盈利能力分析

##### 3、企业偿债能力分析

##### 4、企业运营能力分析

##### 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

#### 第二节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 1、主要经济指标情况

##### 2、企业盈利能力分析

##### 3、企业偿债能力分析

##### 4、企业运营能力分析

##### 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

#### 第三节 企业

##### 一、企业概况

##### 二、主营产品

##### 三、运营情况

##### 1、主要经济指标情况

##### 2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国IC封装行业发展前景分析与预测

第一节 中国IC封装行业未来发展前景分析

一、IC封装行业国内投资环境分析

二、中国IC封装行业市场机会分析

三、中国IC封装行业投资增速预测

第二节 中国IC封装行业未来发展趋势预测

第三节 中国IC封装行业市场发展预测

一、中国IC封装行业市场规模预测

二、中国IC封装行业市场规模增速预测

三、中国IC封装行业产值规模预测

四、中国IC封装行业产值增速预测

## 五、中国IC封装行业供需情况预测

### 第四节中国IC封装行业盈利走势预测

- 一、中国IC封装行业毛利润同比增速预测
- 二、中国IC封装行业利润总额同比增速预测

## 第十二章 2018-2024年中国IC封装行业投资风险与营销分析

### 第一节 IC封装行业投资风险分析

- 一、IC封装行业政策风险分析
- 二、IC封装行业技术风险分析
- 三、IC封装行业竞争风险分析
- 四、IC封装行业其他风险分析

### 第二节 IC封装行业企业经营发展分析及建议

- 一、IC封装行业经营模式
- 二、IC封装行业销售模式
- 三、IC封装行业创新方向

### 第三节 IC封装行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

## 第十三章2018-2024年中国IC封装行业发展策略及投资建议

### 第一节 中国IC封装行业品牌战略分析

- 一、IC封装企业品牌的重要性
- 二、IC封装企业实施品牌战略的意义
- 三、IC封装企业品牌的现状分析
- 四、IC封装企业的品牌战略
- 五、IC封装品牌战略管理的策略

### 第二节中国IC封装行业市场重点客户战略实施

- 一、实施重点客户战略的必要性
- 二、合理确立重点客户
- 三、对重点客户的营销策略
- 四、强化重点客户的管理
- 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

### 第三节 中国IC封装行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国IC封装行业发展策略及投资建议

第一节中国IC封装行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国IC封装行业定价策略分析

第二节中国IC封装行业营销渠道策略

一、IC封装行业渠道选择策略

二、IC封装行业营销策略

第三节中国IC封装行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国IC封装行业重点投资区域分析

二、中国IC封装行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/330008330008.html>